【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和4年11月24日(2022.11.24)

【国際公開番号】WO2020/138335
【出願番号】特願2020-562433(P2020-562433)
【国際特許分類】
*C04B 35/01(2006.01)*
*C08L101/00(2006.01)*
*C08K 3/01(2018.01)*
【ＦＩ】
C04B 35/01
C08L101/00
C08K 3/01

【手続補正書】
【提出日】令和4年11月15日(2022.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
放熱性樹脂組成物に使用される無機粉体であって、
粒径５３μｍ未満の第１の無機粒子と、ＢＥＴ比表面積が２$m^2$/ｇ以下である、粒径１００μｍ以上の第２の無機粒子とを含み、
前記第２の無機粒子の含有量が３０～９５質量％である、無機粉体。
【請求項２】
断面ＳＥＭ像において、前記第２の無機粒子の内部に存在する孔は、最大寸法４０μｍ未満である、請求項１に記載の無機粉体。
【請求項３】
さらに、粒径５３μｍ以上、１００μｍ未満の第３の無機粒子を含む、請求項１または２に記載の無機粉体。
【請求項４】
樹脂と、請求項１～３のいずれかに記載の無機粉体と、を含む放熱性樹脂組成物であって、
前記樹脂１００重量部に対し、前記第２の無機粒子を１００重量部以上含む、放熱性樹脂組成物。
【請求項５】
放熱性樹脂組成物に使用される、無機粒子を含む無機粉体の製造方法であって、
粒径５３μｍ未満の第１の無機粒子と、ＢＥＴ比表面積が２$m^2$/ｇ以下である、粒径１００μｍ以上の第２の無機粒子とを、前記無機粉体が前記第２の無機粒子を３０～９５質量％含むように混合する工程を含む、無機粉体の製造方法。
【請求項６】
前記第１の無機粒子および／または前記第２の無機粒子と、粒径５３μｍ以上、１００μｍ未満の第３の無機粒子を混合する工程をさらに含む、請求項５に記載の無機粉体の製造方法。
【請求項７】
樹脂と、無機粒子を含む無機粉体とを含む放熱性樹脂組成物の製造方法であって、

粒径５３μｍ未満の第１の無機粒子と、ＢＥＴ比表面積が２ｍ$^2$/ｇ以下である、粒径１００μｍ以上の第２の無機粒子と、樹脂原料とを、前記無機粉体が前記第２の無機粒子を３０～９５質量％含むように、かつ、前記樹脂原料１００重量部に対し、前記第２の無機粒子が１００重量部以上で配合されるように、混合する工程と、

得られた混合物を成形する工程と、を含む放熱性樹脂組成物の製造方法。

【請求項８】

前記無機粉体は、粒径５３μｍ以上、１００μｍ未満の第３の無機粒子をさらに含む、請求項７に記載の放熱性樹脂組成物の製造方法。